证券代码: 003026 证券简称: 中晶科技



浙江中晶科技股份有限公司 2022 年非公开发行 A 股股票募集资金使用 可行性分析报告

二〇二二年十二月



浙江中晶科技股份有限公司(以下简称"公司")为满足公司业务发展的资金需求、优化资产负债结构、增强公司的抗风险能力,计划向特定对象发行 A 股股票募集资金(以下简称"本次发行"或"本次向特定对象发行")。公司董事会对本次向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析如下:

一、本次非公开发行募集资金使用计划

本次非公开发行股票预计募集资金总额不超过 50,000 万元。募集资金扣除 发行费用后的净额拟用于以下项目:

单位:万元

序号	项目	实施主体	投资总额	募集资金投入
1	年产 250 万片 6 英寸 高端功率器件用单晶 硅抛光片项目	中晶新材料	40,756	40,000
2	补充流动资金	中晶科技	10,000	10,000
合计		-	50,756	50,000

本次非公开发行募集资金到位之前,公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入,待本次发行募集资金到位后将以募集资金予以置换。若本次发行实际募集资金净额低于拟投入募集资金额,公司将根据实际募集资金净额,按照项目实施的具体情况,调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额,募集资金不足部分由公司自筹解决。

二、本次发行募集资金投资项目的基本情况

(一) 高端功率器件用单晶硅片项目

1、项目基本情况

本项目总投资 40,756 万元,由浙江中晶新材料研究有限公司(简称"中晶新材料")作为项目的实施主体,拟使用募集资金 40,000 万元,利用厂区现有土地及厂房,新建配套设施,购置晶体生长、切片研磨、热处理、抛光、清洗及检测等设备,建设"年产 250 万片 6 英寸高端功率器件用单晶硅抛光片项目"。

2、项目建设的必要性



(1) 抓住半导体硅片市场快速发展的机遇

伴随着全球科技进步,5G 技术、人工智能、新能源汽车等技术的产业化应用,全球半导体市场预计将持续增长。根据 WSTS 数据,全球半导体销售额从2012年2,916亿美元增长至2021年5,559亿美元,预计2022年将进一步增长至5,730亿美元。其中,硅片作为半导体材料中最主要的组成部分,市场规模同样快速增长。根据 SEMI 公布数据显示,2021年,全球硅片出货面积达142亿平方英寸,同比增长14%;全球半导体硅片市场规模为126亿美元,同比增长13%。

目前,我国半导体产业仍处于产业生命周期的成长期,规模继续扩大,技术快速提升,产品不断更新。与此同时,中美关系的不确定性也给中国企业半导体供应链的稳定性带来了挑战,半导体产业的国产替代也已成为大势所趋。因此,我国半导体产业市场预计将得到快速发展,产业链上游的半导体硅片市场空间巨大。

(2) 提高单晶抛光片生产能力和批量供货能力,进一步提升规模效应

对于半导体硅材料制造企业而言,在一定条件下,随着生产规模的扩大,其管理费用、销售费用等费用率会随之降低。本次"年产 250 万片 6 英寸高端功率器件用单晶硅抛光片项目"在中晶新材料现有土地和厂房内进行建设,可通过扩大生产规模,发挥规模效应,有效分摊固定成本,降低产品单位生产成本。本项目的建设将进一步提升公司的规模效应优势,提高公司的盈利能力。

另一方面,由于半导体产业链较长,公司下游客户对于半导体抛光片供应商 稳定的产品质量及批量供货能力要求较为严格。本项目实施后,公司抛光片产能 将进一步提升,可满足下游客户稳定批量供货的需求,提高公司与客户的粘性。

(3) 丰富公司产品结构,提升市场竞争力

公司原有"高端分立器件和超大规模集成电路用单晶硅片项目"目前处于 试生产阶段,部分产品已通过相关客户等认证,后续将逐步进入批量生产阶段。 上述项目所生产的高端分立器件用单晶硅片以应用于消费电子、家用电器、通讯 安防、绿色照明等消费领域的轻掺单晶硅片为主。

本次募投项目以重掺系列单晶硅片产品为主导,产品具有超低电阻率、低氧



含量以及高几何平整度的特点,重掺系列单晶硅片可拓宽应用至工业领域,如清洁能源、新能源汽车等。本项目实施后,有利于公司进一步丰富产品结构,提升产品竞争力,从而扩大公司的市场份额、提升行业地位。

3、项目建设的可行性

(1) 行业政策为项目实施营造良好环境

在信息技术革命的浪潮下,半导体行业作为信息技术产业的核心,是国家经济和国家安全的基础,也是国家政策重点支持的领域。近年来,国家高度重视半导体产业的发展并出台了一系列政策,《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》、《基础电子元器件产业发展行动计划(2021-2023年)》、《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》等产业政策均将半导体产业列为重点发展领域。国家政策的支持为半导体硅材料行业的发展奠定了坚实的基础,为本次募投项目的实施创造了良好的政策环境。

(2) 公司具备稳定的市场及客户基础

公司作为国内领先的单晶硅材料供应商,经过多年潜心发展,研发能力、生产管理、质量控制、及时交付能力等得到客户的广泛认可,亦在行业内建立了较高的品牌认知度。截至目前,公司部分规格的6英寸单晶硅抛光片已经陆续通过浙江晶睿电子科技有限公司、福州福顺微电子有限公司、浙江芯动科技有限公司等客户的认证,计划进行小批量试生产。

本次非公开发行的募集资金投资项目是公司在单晶硅抛光片业务领域的进一步拓展和延伸,有助于公司提高产品竞争力,扩大客户范围,增加客户黏性,进而提高公司持续经营能力和抗风险能力。公司具备稳定的市场和客户基础。

(3) 公司具备项目建设所需的技术能力

公司自成立以来一直从事半导体硅材料的研发、生产和销售,积累了丰富的生产经验,并形成了具有较强竞争力的核心技术优势,如磁场直拉法拉晶技术、再投料直拉技术、金刚线多线切割技术、高精度重掺杂技术等。针对单晶硅抛光片,公司在重掺硅片酸碱腐蚀 TTV 管控、低应力背面多晶和二氧化硅背封、高



平坦度有腊贴片单面抛光、低颗粒度和金属离子杂质含量的抛光片清洗等方面积累了自主研发的核心技术。

公司目前拥有 42 项发明专利,74 项实用新型专利。在坚持技术创新的原则下,公司将进一步加大研发投入,提升研发水平。公司的研发能力可以为本项目提供技术支撑,从而保障本项目技术路径与行业技术发展趋势、客户需求保持高度相关,公司具备项目建设所需的技术能力。

4、项目投资概算

本项目预计总投资为40,756万元,具体如下表所示:

序号	项目	金额(万元)	所占比例
_	建设投资	35,756.00	87.73%
1	设备购置及安装费	33,877.00	83.12%
2	配套设施及建造费	1,879.00	4.61%
=	铺底流动资金	5,000.00	12.27%
合 计		40,756.00	100.00%

5、项目经济效益分析

经过可行性论证及项目收益测算,本次募集资金投资项目具有良好的经济效益。

6、项目用地情况

本项目建设地点为浙江省湖州市长兴县太湖街道陆汇路 69 号,在中晶新材料现有土地和厂房内进行建设,不涉及新增用地和新增建筑物。中晶新材料已取得现有厂房和土地的不动产权证书:浙(2019)长兴县不动产权第 0003641 号。

7、项目批复或备案情况

截止本预案公告日,公司尚未完成项目立项备案及环评批复。

(二)补充流动资金

1、项目基本情况

公司拟将 10,000.00 万元用于补充流动资金,以增强公司的资金实力,优化



公司资本结构, 改善财务状况, 满足未来业务不断增长的营运资金需求。

2、必要性与可行性分析

(1) 补充营运资金,满足公司业务发展所需

受益于行业的快速发展,公司积极拓展业务范围,同时需要投入大量的资金 用于购置设备。未来,随着公司现有产能的释放和新增产能的投产,公司对营运 资金的需求将进一步扩大,补充流动资金将有助于提升公司营运能力和扩张公司 业务规模。

(2) 优化资本结构,降低流动性风险,提高抗风险能力

补充流动资金有利于解决公司快速发展过程中的资金短缺问题,也有利于优化资本结构和改善财务状况。本次发行完成后,公司的资产负债率将进一步降低,有利于优化公司的资本结构、降低流动性风险、提升公司的抗风险能力。

三、本次非公开发行对公司经营管理、财务状况等的影响

(一) 本次非公开发行对公司经营管理的影响

本次非公开发行募集资金主要用于实施"年产 250 万片 6 英寸高端功率器件 用单晶硅抛光片项目"以及补充流动资金。项目建成并达产后,公司抛光片的生 产能力将得到提升,产品结构更加完整丰富,同时发挥规模效应,降低产品单位 生产成本,有助于公司提升综合竞争力,巩固并加强行业地位,对实现公司可持 续发展具有重要意义。

(二) 本次非公开发行对公司财务状况的影响

本次非公开发行完成后,公司的总资产与净资产将同时上升,资产负债率将 有所降低,资本实力得以提升,公司整体财务状况将得到进一步改善,抵御财务 风险的能力将进一步增强。

本次募集资金投资项目符合国家相关的产业政策及未来公司整体战略的发展方向,具有良好的市场发展前景和经济效益,将进一步提升公司的营业收入和盈利水平,符合公司及全体股东的利益。



(三)本次非公开发行对即期回报的影响

本次非公开发行完成后,公司股本将有所增加,公司净资产规模也将有所提升。募集资金投资项目的实施需要一定的建设周期,其经济效益需要一定的时间才能体现。若公司未来净利润增长幅度低于净资产和总股本的增长幅度,或进一步发生亏损,公司存在净资产收益率下降及每股收益被摊薄的可能性。公司拟通过提升公司管理水平,不断完善公司治理结构,加强募集资金的管理,提高资金使用效率,完善利润分配政策等措施,提升资产质量,实现公司的可持续发展,以填补股东回报。同时,公司实际控制人、控股股东、董事及高级管理人员也就保证公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。

浙江中晶科技股份有限公司

董事会

2022年12月9日